

2020-2026年中国LED用 衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国LED用衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202007/174513.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

硅衬底LED芯片是GaN基在硅衬底上制造的一种led芯片，硅衬底LED芯片问世不久，但是在硬度、导电性、导热性、价格及加工工艺上已经相较传统LED芯片有了明显的优势，受到业界的广泛关注。中企顾问网发布的《2020-2026年中国LED用衬底材料产业发展现状与投资潜力分析报告》分析了LED用衬底材料行业的产业链，竞争格局，面临的机遇及挑战以及发展前景等，您若想对中国LED用衬底材料行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录:第一章 led用衬底材料产业相关概述 第一节 半导体照明器件核心组成 第二节 led外延片 一、led外延片基本概念 二、led衬底材料发展对外延片环节的作用三、红黄光led衬底 四、蓝绿光led衬底 第三节 led芯片常用的三种衬底材料性能比较 一、蓝宝石衬底二、硅衬底三、碳化硅衬底 第四节 衬底材料的评价 第二章 2019年中国半导体照明（led）产业整体运行态势分析 第一节 2019年全球led产业现状与发展 一、世界半导体照明产业三足鼎立竞争格局形成 二、国际半导体照明行业研究及应用进展分析 三、全球led封装、芯片产需状况 四、国际半导体照明行业发展的驱动因素分析 五、半导体照明新兴应用领域 第二节 中国半导体照明产业链分析 一、我国的半导体照明产业链日趋完整 二、上游环节 产业链 三、中游环节（芯片制备）产业链 四、下游环节（封装和应用）产业链 第三节 2019年中国半导体照明行业发展概况分析 一、我国的半导体照明产业发展初具规模 二、中国半导体照明工程分析 三、中国led设备产能状况分析 四、中国led产业热点问题探讨 第四节 2019年中国半导体照明应用市场发展现状分析 一、中国led产品主要应用领域浅析 二、中国led应用市场发展概况分析 三、新兴应用市场带动led行业发展 四、led光源大规模应用尚未成熟 第三章 2019年国内外led衬底材料产业运行新形势透析 第一节 2019年全球led衬底材料产业运行总况 一、产业运行环境及影响因素分析 二、led衬底材料需求与应用分析 三、led衬底材料研究新进展 第二节 2019年中国led衬底材料产业现状综述 一、衬底技术进步快集成创新成led产业发展重点 二、衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线 三、衬底材料研究进展 四、led产业对衬底材料的推动 第三节 2019年中国led衬底材料产业热点问题探讨 第四章 2011-2019年中国led衬底材料行业数据监测分析 第一节 2011-2019年中国led衬底材料行业规模分析 一、企业数量增长分析 二、从业人数增长分析 三、资产规模增长分析 第二节 2019年中国led衬底材料行业结构分析 一、企业数量结构分析 二、销售收入结构分析 第三节 2011-2019年中国led衬底材料行业产值分析 一、产成品增长分析 二、工业销售产值分析 三、出

口 教货值分析第四节 2011-2019年中国led衬底材料行业成本费用分析一、销售成本统计二、费用统计第五节 2011-2019年中国led衬底材料行业盈利能力分析 一、主要盈利指标分析二、主要盈利能力指标分析 第五章 2019年中国led衬底材料细分市场分析——蓝宝石衬底 节 蓝宝石衬底基础概述一、蓝宝石衬底标准二、蓝宝石衬底主要类型和应用领域三、蓝宝石衬底主要技术参数及工艺路线四、外延片厂商对蓝宝石衬底的要求五、蓝宝石生产设备的情况第二节 2019年中国蓝宝石衬底材料市场动态聚焦 一、国产led蓝宝石晶片形成规模化生产二、下游扩张推动蓝宝石衬底需求持续走高 三、我国蓝宝石衬底白光led有很大突破 第三节 2019年中国蓝宝石项目生产分析 一、原料 二、生产线设备 三、2019年国内宝蓝石材料项目新进展 第四节 市场对蓝宝石衬底的需求分析 一、民用半导体照明领域对蓝宝石材料的需求分析二、民用航空领域对蓝宝石衬底的需求分析 三、军工领域对蓝宝石材料的需求分析 四、其他领域对蓝宝石材料的需求分析 第五节 蓝宝石衬底材料的发展前景 一、2019年全球led蓝宝石衬底的需求预测 二、2019年市场对led蓝宝石衬底的需求将暴增 三、蓝宝石衬底材料的发展趋势 第六章 2019年中国led衬底材料细分市场透析——硅衬底 节 半导体硅材料的概述 一、半导体硅材料的电性能特点 二、半导体硅材料的制备 三、半导体硅材料的加工 四、半导体硅材料的主要性能参数 第二节 硅衬底led芯片主要制造工艺的综述 一、si衬底led芯片的制造 二、si衬底led封装的技术 三、硅衬底led芯片的测试结果 第三节 硅衬底上gan基led的研究进展 一、用硅作gan led衬底的优缺点 二、硅作gan led衬底的缓冲层技术 三、硅衬底的led器件 第四节 2019年中国硅衬底技术产业化分析 第五节 2019年中国硅衬底发光材料批量生产情况 第六节 国内外市场对硅衬底材料市场的需求 一、led产业对硅衬底材料的需求潜力分析 二、硅衬底材料在其他新兴领域的需求 第七章 2019年中国led衬底材料细分市场探析——碳化硅衬底 节 碳化硅衬底的介绍一、碳化硅的性能二、硅衬底材料的优势三、碳化硅主要类型及应用领域四、碳化硅衬底标准 第二节 sic半导体材料研究的阐述一、sic半导体材料的结构 二、sic半导体材料的性能 三、sic半导体材料的制备方法 四、sic半导体材料的应用 第三节 sic单晶片cmp超精密加工的技术分析 一、sic单晶片超精密加工的发展 二、sic单晶片的cmp技术的原理 三、sic单晶片cmp磨削材料去除速率 四、sic单晶片cmp磨削表面质量 五、cmp的影响因素分析六、sic单晶片cmp抛光存在的不足七、sic单晶片的cmp的趋势 第四节 2019年国内外碳化硅衬底行业的需求分析 一、国内市场对碳化硅衬底的需求分析二、军事领域对碳化硅衬底的需求分析 第八章 2019年中国led衬底材料细分市场投视——申化镓衬底 节 申化镓的介绍一、申化镓的属性二、申化镓材料的分类第二节 申化镓外延片的加工技术一、申化镓外延片的工艺法二、led使用中申化镓外延材料的性能要求第三节 申化镓衬底材料的发展一、国内申化镓材料主要生产厂家的情况二、申化镓外延衬底市场规模预测第四节 申化镓在光电子领域的应用一、申化镓在led方面的需求市场 二、我国led方面申化

镓的应用 第九章 2019年中国其他衬底材料市场分析节 氧化锌一、氧化锌的定义二、氧化锌的理化性能指标三、氧化锌晶体应用及发展第二节 氮化镓一、氮化镓的介绍二、gan材料的特性三、gan材料的应用四、氮化镓晶体应用及发展五、氮化镓材料的应用前景广阔第三节 硼化锆一、硼化锆晶体概述二、硼化锆晶体应用及发展第四节 金属合金一、金属合金衬底概述二、金属合金衬底应用及发展第五节 其他晶体材料一、镁铝尖晶石二、 $LiAlO_2$ 和 $LiGaO_2$ 第十章 2019年中国led用衬底材料产业竞争态势分析 第一节 2019年中国led用衬底材料产业竞争格局分析 一、led用衬底材料业竞争程度 二、led用衬底材料竞争环境及影响因素分析三、中国衬底材料国际竞争力分析第二节 2019年中国led用衬底材料市场集中度分析第三节 2020-2026年中国led用衬底材料竞争趋势预测分析 第十一章 2019年国内及台湾led用衬底材料重点企业分析节 国外主要企业一、京瓷 (kyocera) 二、namiki 三、rubicon四、cree 第二节 中国台湾主要企业一、台湾越峰电子材料股份有限公司二、台湾中美硅晶制品股份有限公司三、台湾合晶科技股份有限公司四、台湾鑫晶钻科技股份有限公司 第十二章 2019年国内led用衬底材料重点企业运营关键性财务指标分析 第一节 水晶光电 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第二节 天通股份 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第三节 武汉博达晶源光电材料有限公司 一、企业基本概况 二、公司主要财务指标分析 三、企业成本费用指标 第四节 哈尔滨工大奥瑞德光电技术有限公司 一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标 第五节 云南省玉溪市蓝晶科技有限责任公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第六节 成都聚能光学晶体有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第七节 青岛嘉星晶电科技股份有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标第八节 爱彼斯通半导体材料有限公司一、企业基本概况二、公司主要财务指标分析三、企业成本费用指标 第十三章 2020-2026年中国led用衬底材料产业前瞻与新趋势探析 第一节 2020-2026年中国半导体照明 (led) 产业前景预测第二节 2020-2026年中国led用衬底材料趋势探析 一、氮化物衬底材料与半导体照明的应用前景二、led蓝宝石衬底晶体材料应用前景预测 三、led用衬底材料发展新趋势分析第三节 2020-2026年中国led用衬底材料市场前景预测 一、中国led用衬底材料市场需求预测分析 二、led衬底销售规模预测分析第四节 2020-2026年中国发展led用衬底材料带动作用分析及建议一、积极部署衬底材料产业发展布局将有效打开led上游产业环节二、led衬底材料的种类随着gan器件的发展而逐渐发展起来三、发展国内外延片环节的重要力量 第十四章 2020-2026年中国led用衬底材料投资前景预测 205 () 第一节 2019年中国led用衬底材料投资概况 一、led用衬底材料投资环境分析二、led用衬底材料投资与在建项目分析 三、2011-2019年将是led照明产业佳投资时期 第二节 2020-2026年中国led用衬底材料投资机会分析一、led用衬底材料投资热点分析 二、与产业链相关的投资机会

分析第三节 2020-2026年中国led行业上游投资风险预警 一、宏观调控政策风险二、市场竞争风险（ ）三、技术风险四、市场运营机制风险第四节 投资观点

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202007/174513.html>